

玻璃失效分析，烧蚀实验

产品名称	玻璃失效分析，烧蚀实验
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

玻璃失效分析，烧蚀实验

反应离子刻蚀（RIE）、微漏电侦测系统（EMMI）、X-Ray检测，缺陷切割观察系统（FIB系统）等检测试验。实现对智能产品质量的评估及分析，为智能装备产品的芯片、嵌入式软件以及应用提供质量保证。咨询13488683602 微信icfa88 去Polyimide

聚酰亚胺(Polyimide，有时简称为PI)，是综合性能zuijia的有机高分子材料之一。其耐高温达400 ° C以上，长期使用温度范围-200~300 ° C，部分无明显熔点，高绝缘性能去Poly

在集成电路设计领域，POLY表示多晶材料(通常是多晶硅)的区域 去绝缘层 芯片表面绝缘层厚度对石墨烯散热效果的影响摘要随着晶体管和集成电路尺寸的减小及密度的增加,芯片级的功率密度和空间分布给热管理带来了极大挑战..... 去保护层 一般芯片表面保护层都是钝化层，材质为二氧化硅 氮化硅

rie就可以去 去Substrate 基材。多为硬质或软质绝缘板材，用于承载印制导电图形 去BGA上的PCB板 半导体检测实验室，能够依据国际、国内和行业标准实施检测工作，开展从底层芯片到实际产品，从物理到逻辑全面的检测工作，提供芯片预处理、侧信道攻击、光攻击、侵入式攻击、环境、电压毛刺攻击、电磁注入、放射线注入、物理安全、逻辑安全、功能、兼容性和多点激光注入等安全检测服务，同时可开展模拟重现智能产品失效的现象，找出失效原因的失效分析检测服务，主要包括点针工作站（Probe Station）、反应离子刻蚀（RIE）、微漏电侦测系统（EMMI）、X-Ray检测，缺陷切割观察系统（FIB系统）等检测试验。实现对智能产品质量的评估及分析，为智能装备产品的芯片、嵌入式软件以及应用提供质量保证。